

武汉回收电子元件武汉回收电子料武汉收购IC

产品名称	武汉回收电子元件武汉回收电子料武汉收购IC
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	168.00/个
规格参数	铭盛电子科技:13631665055 型号:MAX4375FEUB+ 加微:长期合作
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

产品详情

武汉回收电子元件武汉回收电子料武汉收购IC-铭盛电子科技有限公司

1、BGA

(ball grid array)

球形触点阵列，表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按阵列方式制作出球形凸点用以代替引脚，在印刷基板的正面装配LSI

芯片，然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点阵列载体(PAC)。引脚可超过200，是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如，引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅为31mm见方；而引脚中心距为0.5mm的304引脚QFP为40mm见方。而且BGA不用担心QFP那样的引脚变形问题（见有图所示）。

2、BQFP

(quad flat package with bumper)

带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP封装之一，在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC等电路中采用此封装。引脚中心距0.635mm，引脚数从84到196左右(见QFP)。

3、C -

(ceramic)

表示陶瓷封装的记号。例如，CDIP 表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。

4、Cerdip

用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装，用于ECL RAM，DSP(数字信号处理器)等电路。带有玻璃窗口的Cerdip 用于紫外线擦除型EPROM以及内部带有EPROM 的微机电路等。引脚中心距2.54mm，引脚数从8到42。在日本，此封装表示为DIP - G(G即玻璃密封的意思)。